

079A-2601-48.00MHz 上板晶体与PCB的间隙中锡珠分析报告

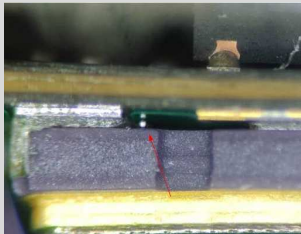
报告者

TOYOICHI

2020.08.05

刘正军

生产情报信息

拉线	机型	生产数	订单号	生产日期	反馈问题	数据把握	反馈日期
L3	079A-2601-48.00MHz	3895 3989	11200400311 11200400313	7.24 7.26		1.34% 7.00%	2020.8.4

原因分析

对策实施

原因分析	对策内容			
钢网开口比晶体焊盘过大，晶体本体接触挤压锡膏渗出到焊盘外，回流后锡膏断节，不能完全收缩到焊盘上，产生锡珠。	建议修改钢网开口比例，内缩。			

最终案推行

最终改善方案推行	现状钢网开口	现状钢网产生锡珠原因	建议修订钢网开口方案	修订钢网开口实际印刷与贴装
对钢网开口进行适量内切，减少元件本体与锡膏的接触面积。	现状钢网开口与PCB焊盘1:1开，没有考虑晶体实际焊盘尺寸	从钢网开口与晶体焊盘进行重叠上看锡膏比例较大，晶体本体接触挤压锡膏渗出到焊盘外，回流后锡膏断节，不能完全收缩到焊盘上，产生锡珠。	建议修改钢网开口比例，内缩。使锡膏受到晶体本体挤压后渗入空间仍保留在焊盘上，回流后锡膏能收缩到焊盘上	下图焊盘，锡膏，晶体三点重叠露出黄色的为焊盘，露出部份有利于晶体对锡膏挤压后，锡膏形状变形的焊接空间，减少因本体挤压渗出的锡珠发生。
	